2026/4/21 星期二 中国证券报

公司代码:688783 公司简称:西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

报告期内,公司实现产量859.02万片,较上年增长33.55%,销量807.37万片,较上年同期增长29.08%,实现营业收入264,922.46万元,较上年同期增长24.88%,主要受新工厂产能爬坡导致转固折旧尚未被充分摊薄、持续高强度研发投入及市场增长传导的滞后性,综合导致公司尚未实现盈利,其中:报告期内,归属于母公司股东的净利润为-73,817.08万元,与上年基本持平,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-80,933.75万元,较上年亏损扩大6.14%,截至报告期末,归属于母公司股东的未弥补亏损为266,567.72万元。

外部市场方面,根据SEMI最新发布的硅片行业年终分析报告,2025年全球硅片出货面积同比增长5.8%,销售额同比下降1.2%。虽然数据中心与AI等领域投资维持高位,先进制程细分市场需求旺盛,但下游需求向硅片环节传导存在一定滞后性;另一方面,汽车、工业及消费电子等传统应用仍处于库存调整阶段,整体供需关系尚未显著改善;加之国内硅片厂扩产产能集中释放,12英寸硅片竞争加剧,产品价格阶段性承压。

内部经营方面,受到客户产能释放节奏、半导体硅片产品认证周期等因素影响,公司产品结构尚需进一步优化,报告期内公司正片(不含高端测试片)占主营业务收入比例约为60%,正片占比尤其是应用于逻辑芯片的外延片产品占比尚需进一步提升。此外,公司上市募投项目即第二工厂总投资约125亿元,处于产能爬坡阶段,截至报告期末已具备20万片/月产能,较规划产能尚未完全释放,固定资产折旧等固定成本未能实现有效摊薄,规模效应暂未充分显现;加之公司为保障核心竞争力,报告期研发投入28,515.26万元,占营业收入比例10.76%,持续维持较高强度的研发投入。多重因素共同导致报告期内公司业绩亏损。值得关注的是,公司报告期实现经营性现金流净流入40,469.57万元,持续保持现金流净流入,具备良好的可持续经营能力。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,2025年度归属于上市公司股东的净利润为-73,817.08万元,母公司净利润为-12,025.59万元。截至报告期末,母公司未分配利润为-61,618.55万元。

鉴于公司母公司报告期末未分配利润为负数,因此公司2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

由于母公司存在未弥补亏损,2025年度拟不进行利润分配。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	西安奕材	688783	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨春雷	赵润欣
联系地址	陕西省西安市高新区西沣南路1888号	陕西省西安市高新区西沣南路1888号
电话	029-6827 8899(分机号:6927)	029-6827 8899(分机号:6927)
传真	029-6827 8899(分机号:6535)	029-6827 8899(分机号:6535)
电子信箱	ir@eswinsi.com	ir@eswinsi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

硅片是芯片制造的“地基”,其性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力,根据SEMI统计,12英寸硅片贡献了2025年全球所有规格硅片出货面积78.8%,系最主流规格的硅片,尤其是AI时代需要更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互,而用于实现前述功能的市场最主流逻辑和存储芯片(一般90nm工艺制程以下)以及部分高端模拟和传感器芯片均采用12英寸晶圆制造工艺,12英寸晶圆产能是全球晶圆厂扩产的主流方向,未来12英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。公司专注于12英寸硅片的研发、制造和生产,产品广泛应用于消费电子、汽车制造、AI等领域所需要的存储芯片、逻辑芯片、图像传感器、显示驱动芯片、电源管理芯片及IGBT、Power MOSFET等功率器件领域。从下游用途来看,可进一步分为用于芯片制造的正片、用于芯片制造设备调试和检测的测试片。其中,正片分为抛光片、外延片。公司当前主要布局用于存储芯片和逻辑芯片制造的抛光片和外延片,该等产品系市场主流,约占12英寸硅片市场75%份额,正在开拓布局细分市场领域。

1、抛光片

抛光片根据掺杂元素不同,可进一步分为P型轻掺抛光片、N型轻掺抛光片,其中:

(1)P型轻掺抛光片采用硼元素轻掺工艺,具有苛刻的晶体缺陷和纳米形貌等参数要求,主要应用于DRAM、NAND Flash等存储芯片的制造。公司系国内头部存储芯片厂商全球12英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商,同时持续向海外头部存储芯片厂商量产供应及新品导入。

(2)N型轻掺抛光片采用磷元素轻掺工艺,具备高电阻率、低氧含量、低缺陷密度的核心特性。作为功率IGBT器件的核心衬底材料,该产品可助力芯片实现高效能的电能转换与控制,广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、工业变频器等对功率密度和可靠性要求严苛的领域。公司持续优化晶体生长控制系统,成功开发出低氧含量、低晶体原生缺陷密度且电阻率范围可调的N型轻掺抛光片。公司第二工厂新增布局该细分领域,报告期内相关产品开发完成并通过下游客户验证。

2、外延片

外延片根据掺杂元素不同,可进一步分为P型轻掺外延片、P型重掺外延片、N型重掺外延片。其中:

(1)P型轻掺外延片是在P型轻掺抛光片基础上采用化学气相沉积技术生长一层外延层,主要应用于CPU\GPU\手机SOC\嵌入式MCU为代表的逻辑芯片制造,以及部分存储芯片、显示驱动芯片等,逻辑芯片对P型轻掺外延片的外延层形貌、平坦度以及外延层厚度和电阻率均匀性有着较高要求。公司系国内头部晶圆代工厂中国大陆12英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商,同时持续向海外头部晶圆代工厂量产供应及新品导入。

(2)P型重掺外延片是在P型重掺抛光片基础上生长一层外延层。其衬底的低电阻率等特性能够提升图像传感器芯片的光电转换效率与信号灵敏度,是图像传感器芯片的核心基底材料,公司针对体微缺陷(BMD)精准管控,开发重掺硼晶体生长工艺,实现BMD密度在一定区间范围可调,以满足图像传感器芯片对于BMD吸杂的高要求。同时,公司持续加强各工艺段污染管控技术,降低硅片表金属、层金属和体金属水平。公司相关产品最高已在40nm背照式CIS产品量产应用。

(3)N型重掺外延片是在高掺杂浓度的N型重掺抛光片所需工序基础上生长外延层,具有低导通电阻和高外延晶体质量的双重优势。该产品主要应用于制造Power MOSFET功率芯片。Power MOSFET功率器件对电阻率和电阻率均匀性要求极高,公司开发了重掺红磷晶体生长控制系统,成功拉制出重掺红磷的N++晶体,实现产品超低电阻率可控。公司第二工厂新增布局该细分领域,报告期内相关产品已开发完成,正在推进客户送样工作。

3、测试片

测试片用于晶圆厂对产线设备、工艺环境的调试、检测和验证,不直接用于晶圆制造。由于应用要求不同,测试片具有不同的等级,不同等级测试片之间产品技术参数和单价有明显差别,部分测试片的品质要求和价格与抛光片相近,甚至更高。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司专注于12英寸硅片的研发、制造和销售业务,系国内唯一专注于该领域的厂商,通过向下游芯片制造商提供12英寸硅片实现收入、取得利润。一方面,公司凭借国内领先的市场地位及技术水平,不断优化产品结构,提高收入水平;另一方面,公司建立智能化生产体系,具备较高的系统化成本管控能力,不断提升精益化管理水平,持续提升盈利能力。

2、研发模式

公司高度重视自主研发及知识产权保护,建立了“量产一代、储备一代、研发一代”研发体系,汇聚“产学研”多方力量,担当地方产业链“链主”责任,联合产业链上下游企业共同攻关,协同创新。

公司作为研发技术中心,负责前瞻性技术研究,若研发项目需依托产线开展试验、验证、量产等相关工作时,则以公司为主体,各工厂协同配合,共同推进联合研发。其次,公司将研发活动分为技术研发、产品研发、工艺研发三大类:

(1)技术研发:公司基于现有能力,针对新技术的创新性研发活动,包括但不限于针对新技术自主设计设备核心部件、新工艺的前瞻性设计、模拟及测试开发等,取得的研发成果一般为新工艺技术、先进的量测技术或创新性成果专利;

(2)产品研发:根据行业规格现状或公司发展计划将新技术应用于产品之上,以满足下游客户技术迭代和应用需求,取得的研发成果一般为导入量产的新产品;

(3)工艺研发:针对已有的工艺流程、工艺方法和材料耗用及配比等方面进行优化调整及设备智能化改造开发,包含原材料、耗材和设备的国产化导入研发项目,取得的研发成果一般为工艺方案文档等;

此外,公司在现有研发体系基础上,不断推进研发体系数字化、标准化,逐步形成多个标准化研发平台,提升资源复用能力及研发效率。

3、采购模式

首先,公司为供应链企划和管理中心,做出采购决策;各工厂为具体采购主体,根据公司采购决策情况与供应商签订采购合同。

其次,公司制定了严格的合格供应商准入制度和供应商管理制度,综合评估产品质量、经营规模、供应能力等因素,参考全球硅片行业头部企业和自身实际情况,将优质供应商纳入合格供应商名录,并对合格供应商实施筛选、调查、分级管理及评价。同时考虑供应商多元化和采购成本优化,公司积极培育12英寸硅片所需原材料、耗材和设备的国产供应商,是陕西省工业和信息化厅确定的“第一批陕西省重点产业链‘链主’企业”。

第三,公司通过询价、比价、议价、招投标方式确定供应商。对于主要原材料,公司采用“以销定产,以产定采,适量备货”的采购模式,一般根据未来一年经营规划制定年度采购方案,根据具体的生产计划、研发计划和安全库存制定采购计划并向供应商下达采购订单。为确保物资供应的稳定性和品质,公司建立了多元化的供应商体系,主要物资合格供应商数量不少于两家,并与合格供应商签订框架协议。对于主要设备采购,公司根据产能建设计划制定设备采购计划,通过招投标、询价、比价方式进行采购。

4、生产模式

首先,公司以各工厂为生产主体,产品完成生产后,均销售至公司,最终由公司统一外售。

其次,公司主要采用“以销定产”的模式,配套建立科学的产销协同机制。首席营销官组织与主要客户一般于年末提前沟通下一年度的采购需求,对生产进行预计和规划;首席营销官组织根据客户具体采购意向和采购订单提出具体生产需求,并制定销售计划;首席制造官组织结合销售计划、材料库存信息制定生产计划。生产完成后,由首席品质官组织对产品质量进行检验后完成入库。鉴于客户及产品认证数量不断增长,考虑客户采购需求以及生产周期等诸多因素,公司会根据市场和客户具体情况提前备货生产,保障供应链响应效率。

第三,公司首席制造官组织下设智造技术中心推进智能化工厂建设,旨在实现产品个性化、设计协同化、供应敏捷化、制造柔性化、服务主动化、决策智能化。在生产过程中,公司利用自动派送系统(RTD)实现对硅片位置的准确定位、智能化分析,从而达到高效的生产运营管理;利用AMHS系统对天车(OHT)与移动机器人的管理调派实现硅片在设备及库房间的自动转运,是目前国内自动化程度最高的硅片工厂之一。同时,公司以ERP系统为企业运营管理的核心系统,综合运用负责产品研发和管理的PLM系统、负责生产制造的MES系统、负责成品入库及交付管理的FGMS系统、负责设备自动化程序的EAP系统等,实现企业运营的高效决策和执行。

此外,公司积极学习、应用AI技术,组建AI智造创新中心,探索将机器学习和大语言模型引入生产制造和运营管理的各个环节,通过建立硅片加工工序纳米形貌预测模型、12英寸专利智能检索系统,持续提升生产智能化水平。未来,公司还将在智能排产、生产异常追溯、开发设计等环节引入AI技术,助力公司生产运营效率、品质管控能力、研发能力的提升。

5、销售模式

首先,公司为对外销售合同签订主体和回款主体。

其次,根据行业惯例,晶圆厂在引入新供应商时,会在审查通过供应商的技术实力、品控体系和产能规模等条件后,要求供应商先行提供测试片进行认证,认证周期正常为3-6个月;认证通过后,可以进行测试片量产供货。测试片量产供货后,根据晶圆厂内部评估,可进一步开展正片验证,验证周期正常为9-12个月;验证通过后,方可实现正片量产供货,后续晶圆厂根据对供应商定期评价增减其供货比例。整体来看,新进入者仅考虑测试片送样到正片量产至少需要1-2年周期,由于认证周期较长并且认证成本较高,一旦认证通过,晶圆厂商通常不会轻易更换供应商。

第三,公司对外销售主要采用直销模式,少量客户由于贸易政策限制等因素采取代理商销售模式,报告期内代理商销售模式收入不超过5%。

2.3所处行业情况

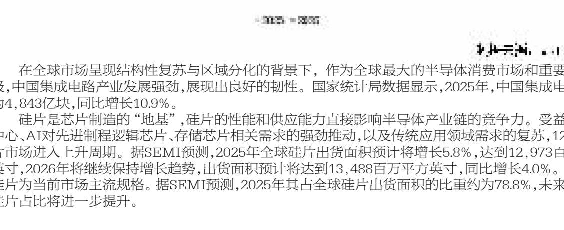
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段

长期来看,半导体行业兼具周期波动与持续成长的双重属性。2022-2024年,全球半导体行业经历周期性调整,市场景气度承压。2025年全球半导体行业迎来结构性复苏,AI、数据中心等应用对算力及存储领域需求的增长成为驱动行业增长的核心引擎,传统应用需求逐步复苏,库存持续调整,行业整体处于筑底调整与动能积蓄阶段。据WSTS预测,2025年全球半导体市场规模将达到7,956亿美元,同比增幅扩大至26.2%。2026年半导体市场规模将逼近万亿美元,分区域来看,欧洲和日本表现温和,增速维持在个位数,美洲和亚太地区仍是贡献最强的地区,预计将增长25%至30%。

图1. 全球半导体市场营收预测(单位:十亿美元)

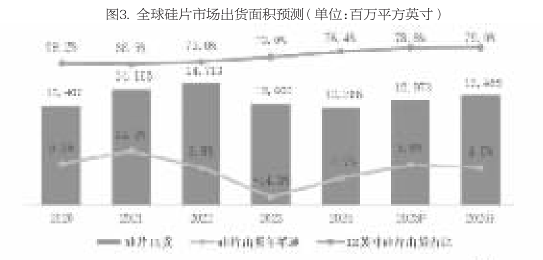
图2. 全球半导体市场各区域营收增速预测



在全球市场呈现结构性复苏与区域分化的背景下,作为全球最大的半导体消费市场和重要的增长极,中国集成电路产业发展强劲,展现出良好的韧性。国家统计局数据显示,2025年,中国集成电路产量为4,843亿块,同比增长10.9%。

硅片是芯片制造的“地基”,硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。受益于数据中心、AI对先进制程逻辑芯片、存储芯片相关需求的强劲推动,以及传统应用领域需求的复苏,12英寸硅片市场进入上升周期。据SEMI预测,2025年全球硅片出货面积预计将增长5.8%,达到12,973百万平方英寸,2026年将继续保持增长趋势,出货面积预计将达到13,488百万平方英寸,同比增长4.0%。12英寸硅片为当前市场主流规格。据SEMI预测,2025年其占全球硅片出货面积的比重约为78.8%,未来12英寸硅片占比将进一步提升。

图3. 全球硅片市场出货面积预测(单位:百万平方英寸)

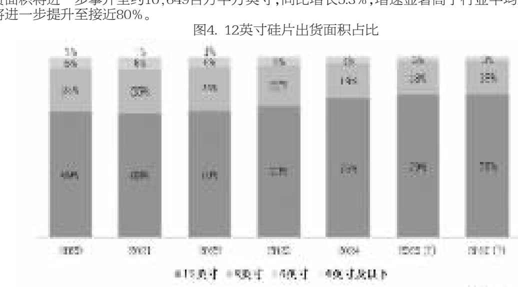


(2)行业的基本特点

从行业周期看,硅片行业与全球半导体市场波动同频,短期虽有起伏,但长期趋势向好。当前行业呈现出先进制程与成熟制程需求显著分化的特征。一方面,数据中心与AI等领域投资维持高位,带动先进制程细分市场需求旺盛,成为市场增长的核心动力,同时推动全产业链在高端领域加大投资、调整布局;另一方面,汽车、工业及消费电子等传统应用库存持续调整。需求的结构分化推动产业链布局加速调整,以匹配市场增长。半导体硅片需求进一步扩大。在AI与多元终端应用的驱动下,2025年晶圆厂持续扩产,带动硅片行业进入上升周期。据SEMI预测,2026年全球12英寸晶圆厂量产数量预计达215座,其中中国大陆将达到70座。全球芯片厂持续扩产,将持续推升12英寸硅片需求。据SEMI预测,2025年全球硅片出货面积将同比增长5.8%至12,973百万平方英寸,并预计在2026年达到约13,488百万平方英寸。

12英寸硅片系硅片市场主流,据SEMI预测,12英寸硅片约贡献了2025年全球所有规格硅片出货面积的78.8%。2025年全球12英寸硅片出货面积预计达到约10,117百万平方英寸,同比增长8.8%。2026年出货面积将进一步攀升至约10,649百万平方英寸,同比增长5.3%,增速显著高于行业平均水平,市场份额将进一步提升至接近80%。

图4. 12英寸硅片出货面积占比



(3)主要技术门槛

半导体硅片是芯片制造的核心基础材料,广泛应用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造。该行业进入壁垒高,具有技术密集、资本密集、研发周期长、客户认证严苛等显著特征。半导体技术向先进制程持续演进,对硅片材料的单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出更严苛要求。作为市场主流的12英寸硅片,技术发展聚焦于缺陷控制、表面平坦度及局部平整度等关键指标,以满足先进存储芯片及高端逻辑芯片的制造需求。这些关键技术的突破与稳定量产能力,是决定产品性能与良率的核心,也构成了行业内企业最主要的竞争壁垒。

公司已掌握多项关键技术,涵盖无缺陷晶体生长技术、翘曲和弯曲控制技术、硅片表面平坦度控制技术、表面污染控制技术以及外延设备基座、反应腔室改善设计等核心技术,实现12英寸硅片全工艺环节覆盖,技术处于国内行业前列,全球竞争力持续增强。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

全球12英寸硅片市场呈现“海外主导、国内追赶”的竞争格局,行业具有技术密集、资本密集、研发与认证周期长等特点,长期由日本信越化学、SUMCO及中国台湾环球晶圆等国际企业主导。在政策引导与产业支持下,国内企业正加快技术突破与产能建设,市场份额逐步提升,国产替代持续深入。

作为国内12英寸硅片头部企业,公司坚持“以客户为中心、以技术为基石、以品质为生命、以成果为导向、以奋斗者为本、以自省促卓越”的核心价值观,秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的愿景。目前,公司系国内头部存储芯片厂商全球12英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商、国内头部晶圆代工厂中国大陆12英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。公司在立足国内市场的同时,持续服务全球客户,报告期内持续向台积电、美光科技、铠侠、格罗方德、力积电、联华电子、华邦、南亚科等稳定批量供货并不断进行新产品验证,首次实现三星电子、东芝少批量测试片供货,正在推动其正片认证工作。整体上,全球前五大厂商仍是海外主流客户的主要供应商,国内供应商占比仍有较大提升空间,提升海外客户供应份额将持续作为公司后续市场开拓的重点工作。展望未来,公司将持续提升产品技术、产品质量与客户服务水平,进一步提升市场竞争力,特别是快速提升海外市场供应量,扩大全球市场份额。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术:发展路径趋于多元,推动硅片价值提升

行业技术正沿着“延续摩尔”和“超越摩尔”两个方向并行发展,拓宽了硅片的市场空间与价值。“延续摩尔”指芯片制程继续微缩至2nm及更先进节点,这对硅片的平整度和缺陷等参数控制提出了更加苛刻的要求,驱动制造技术不断突破极限。“超越摩尔”则指通过集成射频、功率等特色功能来提升芯片性能,这催生了多元化特色硅片产品的快速增长。

(2)新产业:AI等新兴产业有望创造新的增长点

以AI为代表的新兴产业,为硅片行业带来新机遇。AI服务器算力需求激增,叠加高带宽内存(HBM)等关键存储技术的快速迭代,有望创造硅片行业新的增长点。

(3)新业态与新模式:产业链协同深化,响应速度成为关键

为适应技术快速迭代和市场多样化需求,产业内的协作模式与运营方式正在发生深刻变化。下游晶圆厂与硅片供应商的合作关系日益紧密,从传统的买卖关系转向“共同开发、联合认证”的深度绑定模式;并积极将服务向前延伸,配合客户协同开发,以技术服务和快速响应来构建新的竞争优势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,069,812.89	1,742,196.67	18.80	1,549,762.42
归属于上市公司股东的净资产	1,241,705.57	851,481.36	45.83	922,405.46
营业收入	264,922.46	212,145.26	24.88	147,376.14
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	263,607.46	211,087.28	24.88	146,031.45
利润总额	-73,816.97	-73,764.25	不适用	-68,191.43
归属于上市公司股东的净利润	-73,817.08	-73,764.25	不适用	-57,797
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,933.75	-76,255.09	不适用	-69,233.88
经营活动产生的现金流量净额	40,469.57	81,547.82	-50.37	31,990.45
加权平均净资产收益率(%)	-8.24	-8.32	增加0.08个百分点	-6.02
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.21	不适用	-0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.21	不适用	-0.17
研发投入占营业收入的比例(%)	10.76	12.20	减少1.44个百分点	11.63

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	65,415.46	64,828.73	63,026.80	71,651.47
归属于上市公司股东的净利润	-14,483.77	-19,541.68	-21,756.66	-18,034.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,536.37	-20,004.68	-22,239.57	-24,153.13
经营活动产生的现金流量净额	16,851.38	20,704.40	7,453.65	-4,539.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	53,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,939
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京奕斯伟科技集团有限公司		445,627,284	11.04	445,627,284	无		境内非国有法人
北京奕行私募基金管理有限公司-宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)		349,913,933	8.67	349,913,933	无		其他
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)		317,256,738	7.86	317,256,738	无		其他
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司		262,435,103	6.50	262,435,103	无		国有法人
宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)		140,934,731	3.49	140,934,731	无		其他
中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)		122,468,977	3.03	122,468,977	无		其他
嘉兴隽望股权投资合伙企业(有限合伙)		116,637,978	2.89	116,637,978	无		其他
重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝富芯材私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)		113,725,245	2.82	113,725,245	无		其他
中信证券投资有限公司	11,600,928	88,474,921	2.19	88,474,921	无		境内非国有法人
中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司-扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业(有限合伙)		87,477,445	2.17	87,477,445	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)奕斯伟集团直接持有公司11.04%的股份,为公司第一大股东。奕斯伟集团为宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人,北京奕行为宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和基金管理人,奕斯伟集团可全权代表宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)行使对发行人的股东权利,奕斯伟集团和宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系;(2)奕斯伟集团21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业(有限合伙)和宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为宁波宣岳股权投资有限公司;(3)奕斯伟集团21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业(有限合伙)、宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴隽望的唯一有限合伙人,宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)的主要有限合伙人城市更新股权投资(青岛即墨)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人均为国华人寿保险股份有限公司;(4)中信证券投资有限公司为中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)出资比例约0.67%的有限合伙人。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

(下转B133版)

证券代码:688783 证券简称:西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	723,278,008.43	654,154,637.46	10.57
利润总额	-158,324,184.82	-144,837,513.55	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-158,324,184.82	-144,837,695.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,474,342.53	-145,363,673.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	154,248,892.46	168,513,785.24	-8.47
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.28	-1.71	增加0.43个百分点
研发投入合计	60,542,364.36	63,980,459.22	-5.37
研发投入占营业收入的比例(%)	8.37	9.78	减少1.41个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,238,130,107.74	20,698,128,878.55	-7.05
归属于上市公司股东的所有者权益	12,267,789,634.23	12,417,055,724.80	-1.20

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	500,000.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,442,301.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,856.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,150,157.71	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京奕斯伟科技集团有限公司	境内非国有法人	445,627,284	11.04	445,627,284	445,627,284	无	0
北京奕行私募基金管理有限公司-宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	349,913,933	8.67	349,913,933	349,913,933	无	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	其他	317,256,738	7.86	317,256,738	317,256,738	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	262,435,103	6.50	262,435,103	262,435,103	无	0
宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)	其他	140,934,731	3.49	140,934,731	140,934,731	无	0
中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	122,468,977	3.03	122,468,977	122,468,977	无	0
嘉兴隽望股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	116,637,978	2.89	116,637,978	116,637,978	无	0
重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝富芯材私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	113,725,245	2.82	113,725,245	113,725,245	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	88,474,921	2.19	88,474,921	88,474,921	无	0
中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司-扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	87,477,445	2.17	87,477,445	87,477,445	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新理益集团有限公司	1,905,412	人民币普通股	1,905,412
惠盛林	1,567,148	人民币普通股	1,567,148
魏琮	964,000	人民币普通股	964,000
华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划	810,504	人民币普通股	810,504
罗礼添	725,000	人民币普通股	725,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	706,788	人民币普通股	706,788
马健	650,000	人民币普通股	650,000
吴智丽	608,566	人民币普通股	608,566
吴畅	561,811	人民币普通股	561,811
钱耀明	514,051	人民币普通股	514,051
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)北京奕斯伟科技集团有限公司直接持有公司11.04%的股份,为公司第一大股东。北京奕斯伟科技集团有限公司为宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人,北京奕行私募基金管理有限公司为宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和基金管理人,北京奕斯伟科技集团有限公司可全权代表宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)行使对发行人的股东权利,北京奕斯伟科技集团有限公司和宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系;(2)北京奕斯伟科技集团有限公司21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业(有限合伙)和宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为宁波宣岳股权投资有限公司;(3)北京奕斯伟科技集团有限公司21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业(有限合伙)、宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴隽望股权投资合伙企业(有限合伙)的唯一有限合伙人,宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)的主要有限合伙人城市更新股权投资(青岛即墨)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人均为国华人寿保险股份有限公司;(4)中信证券投资有限公司为中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)出资比例约0.67%的有限合伙人。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:西安奕斯伟材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,332,540,384.68	3,526,311,800.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,121,316,234.05	1,752,230,583.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	723,048,741.25	659,777,132.43
应收款项融资		
预付款项	25,221,388.63	26,119,170.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,992,404.46	1,790,603.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,476,823,380.57	1,362,002,646.35
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,472,825.89	30,395,325.90
其他流动资产	26,509,950.05	14,502,908.19
流动资产合计	5,737,925,309.58	7,373,130,171.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,030,000.00	
其他权益工具投资	231,283,950.62	231,283,950.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,866,770,967.91	10,213,262,245.80
在建工程	1,373,249,810.44	1,901,623,988.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,259,098.82	165,039,914.96
无形资产	224,619,197.49	228,676,156.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	62,088,202.67	62,840,955.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	479,903,570.21	522,271,494.96
非流动资产合计	13,500,204,798.16	13,324,998,707.46
资产总计	19,238,130,107.74	20,698,128,878.55
流动负债:		
短期借款	16,756,702.06	16,756,702.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,214,644.83	142,340,591.08
应付账款	546,582,542.27	502,927,623.18
预收款项		
合同负债	686,381.78	1,184,569.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,770,917.36	52,884,851.68
应交税费	8,400,563.05	15,597,093.38
其他应付款	956,685,113.64	993,669,239.71
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,027,987,477.18	1,566,232,355.28
其他流动负债	5,462,157.31	4,959,627.57
流动负债合计	3,799,546,499.48	3,296,552,653.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,843,831,285.95	4,712,680,810.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	166,434,468.58	168,565,032.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	160,528,219.50	103,274,657.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,170,793,974.03	4,984,520,500.71
负债合计	6,970,340,473.51	8,281,073,153.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,037,800,000.00	4,037,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,011,024,629.40	11,002,839,763.06
减:库存股		
其他综合收益	39,453,207.11	39,626,777.52
专项储备	3,513,196.46	2,466,398.14
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,824,001,398.74	-2,665,677,213.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,267,789,634.23	12,417,055,724.80
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	12,267,789,634.23	12,417,055,724.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,238,130,107.74	20,698,128,878.55

公司负责人:杨新元 主管会计工作负责人:王琛 会计机构负责人:邵彬

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:西安奕斯伟材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	723,278,008.43	654,154,637.46
其中:营业收入	723,278,008.43	654,154,637.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,834,197.41	805,409,309.14
其中:营业成本	704,609,801.07	621,571,854.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,402,566.88	6,008,660.87
销售费用	14,968,989.06	13,532,222.76
管理费用	55,253,919.99	53,317,209.29
研发费用	60,542,364.36	63,980,459.22
财务费用	27,056,556.05	46,998,902.06
其中:利息费用	32,100,412.22	48,258,080.10
利息收入	2,294,210.79	10,977,372.98
加:其他收益	25,882,986.73	32,905,285.78
投资收益(损失以“-”号填列)	12,442,301.52	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-729,775.34	-58,515.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-50,571,364.93	-26,455,589.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-158,532,041.00	-144,863,491.72
加:营业外收入	207,856.18	25,978.17
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-158,324,184.82	-144,837,513.55
减:所得税费用		181.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-158,324,184.82	-144,837,695.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-158,324,184.82	-144,837,695.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-158,324,184.82	-144,837,695.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-173,570.41	-79,033.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-173,570.41	-79,033.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-173,570.41	-79,033.06
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-158,497,755.23	-144,916,728.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,497,755.23	-144,916,728.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。

公司负责人:杨新元 主管会计工作负责人:王琛 会计机构负责人:邵彬

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:西安奕斯伟材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,186,042.28	713,129,049.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,655,886.86	42,721,194.20
收到其他与经营活动有关的现金	73,779,020.12	62,225,362.44
经营活动现金流入小计	811,620,949.26	818,075,606.54
购买商品、接受劳务支付的现金	513,175,480.08	481,318,810.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,919,164.35	146,923,959.46
支付的各项税费	15,772,596.12	6,236,522.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,504,816.25	15,082,528.97
经营活动现金流出小计	657,372,056.80	649,561,821.30
经营活动产生的现金流量净额	154,248,892.46	168,513,785.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,415,990,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,356,650.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		24,195,666.00
投资活动现金流入小计	7,428,346,650.81	24,195,666.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,544,262.28	587,908,557.86
投资支付的现金	6,885,020,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,324,564,262.28	587,908,557.86
投资活动产生的现金流量净额	103,782,388.53	-563,712,891.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,256,364.85	307,256,250.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,256,364.85	307,256,250.91
偿还债务支付的现金	1,431,107,668.35	106,085,807.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,606,355.13	46,939,721.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,738,441.33	6,090,258.85
筹资活动现金流出小计	1,469,452,464.81	159,115,787.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,444,196,099.96	148,140,463.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,439,286.59	-248,573.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,189,604,105.56	-247,307,215.95
加:期初现金及现金等价物余额	3,452,286,993.67	3,261,722,872.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,262,682,888.11	3,014,415,656.76

公司负责人:杨新元 主管会计工作负责人:王琛 会计机构负责人:邵彬

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年4月20日